

VECTECH 974
BGA 植球回流台
BGA REBALL REFLOW STATION

使
用
手
冊

感謝您購買此款植球回流台。使用前請仔細閱讀本說明書，閱讀後請妥為保管，以便日後查閱。

目 錄

目 录	1
一、安全说明	錯誤! 尚未定義書籤。
二、概述	錯誤! 尚未定義書籤。
三、规格参数	錯誤! 尚未定義書籤。
四、按键和符号说明.....	錯誤! 尚未定義書籤。
4.1 按键的基本功能.....	錯誤! 尚未定義書籤。
4.2 按键的组合功能.....	錯誤! 尚未定義書籤。
4.3 窗口显示符号说明	錯誤! 尚未定義書籤。
五、操作	錯誤! 尚未定義書籤。
六、参数设置	錯誤! 尚未定義書籤。
七、密码设置	錯誤! 尚未定義書籤。
八、温度校准	錯誤! 尚未定義書籤。

一、安全說明



注意：

- 在加熱過程中，加熱區和加熱蓋部分在工作期間會非常熱，工作中請勿觸摸灼熱的外殼部分，以防燙傷。
- 工作區域內嚴禁易燃易爆的物體或氣體溶劑。

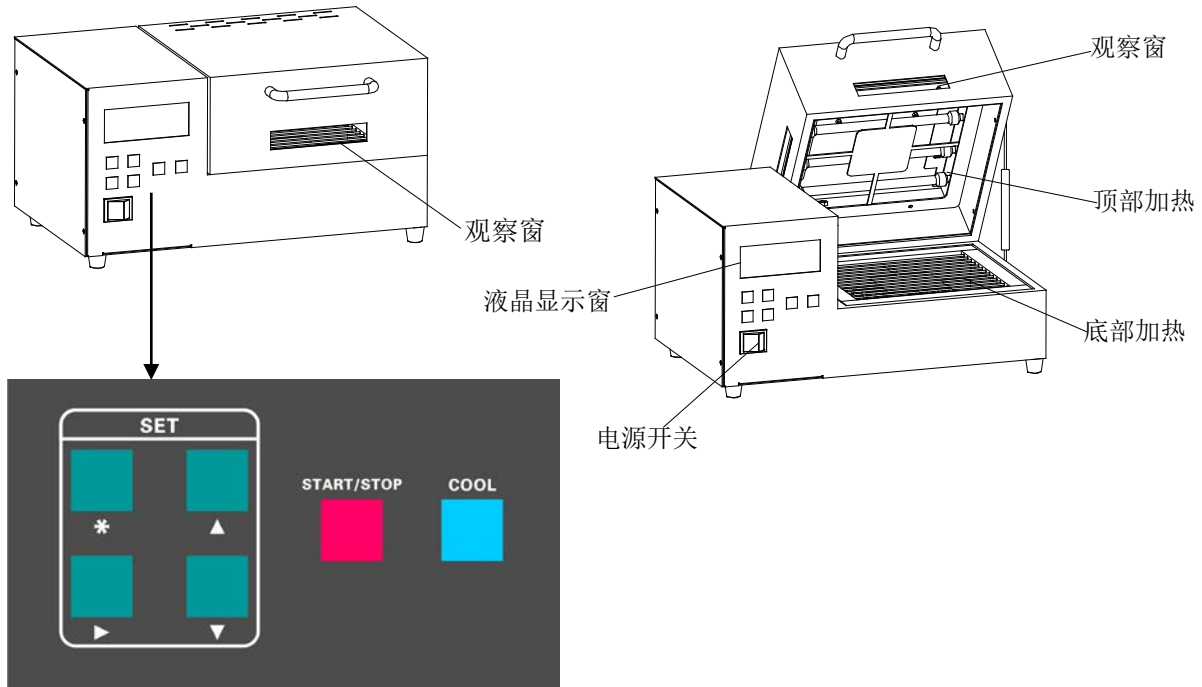


注意：

系統發生故障需要維修時，只能由有經驗的和被授權的專業技術人員才能修理該設備，或是與代理商、本公司聯繫。

二、概述

採用閉環控溫原理，底部採用暗紅外加熱管加熱，頂部採用高紅外加熱管加熱，溫度精確穩定，最大限度的縮小橫向溫差，防止晶片的冷焊或過熱損壞現象。煙霧導流風扇，能夠使焊接過程中的煙霧從殼體後面導出，通過透明觀察窗，能夠清楚的觀察晶片引腳的錫球的熔化情況。當流程結束後，打開箱體，冷卻風扇自動工作吹冷風冷卻工作區。



三、規格參數

總功率：	1000W
電源電壓：	220V AC
溫度範圍：	50℃~350℃
加熱區尺寸：	130mm×130mm
流程組數：	10 組
整機尺寸：	40 (W)×29(D)×20 (H) cm
整機淨重：	9kg

四、按鍵和符號說明

4.1 按鍵的基本功能

1. START/STOP 按鍵：

啟動或停止加熱按鍵。蓋上加熱蓋，單擊“START/STOP”按鍵，進入加熱流程。再次單擊“START/STOP”按鍵，則停止加熱流程。

2. COOL 按鍵：

啟動或關閉冷卻風扇。只有在停止加熱並打開加熱箱後，單擊“COOL”按鍵，才能啟動冷卻風扇。再次單擊“COOL”按鍵，風扇停止工作。

3. * 按鍵：

進入或退出參數設置。

4. ▲或▼按鍵：

進入參數設置後，單擊▲或▼按鍵，調整選定項的參數值。

5. ▶按鍵：

進入參數設置後，單擊“▶按鍵”，進入/選擇下一個需設定的參數，被選中的參數會不斷閃爍。

4.2 按鍵的組合功能

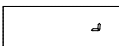
按鍵組合	功能描述
▲+▼+▶	在工作待機視窗(視窗顯示“  ”時)，同時按下這三個鍵，則能打開或關閉提示音。

* +▲+▼+▶	在工作流程中（視窗不顯示“  ”時），同時按下這四個鍵，則進入溫度校準。
----------	---

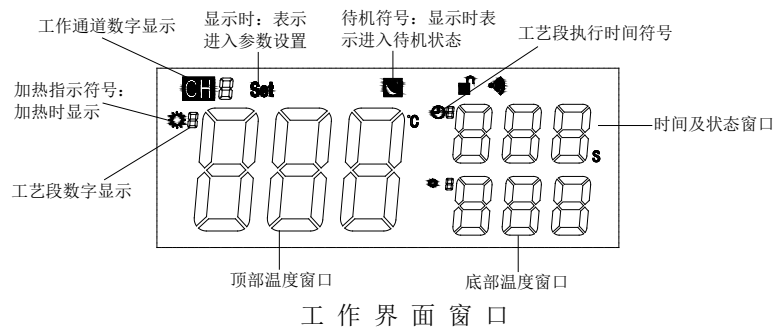
4.3 視窗顯示符號說明

顯示符號	功能描述
	顯示當前工作通道
	表示處於待機狀態
	表示按鍵音/提示音打開
	鎖定參數設置和溫度校準，只能以設置的當前通道及參數工作
	解鎖，可以切換通道工作，設置工作參數
	表示進入密碼輸入視窗
	表示進入密碼修改視窗
Set	表示當前處於參數設置狀態

五、操作

- 從包裝中取出回流台，放在平整的工作臺面上。
- 連接三芯電源線，接通電源。注意：使用規定的額定電壓。
- 蓋上加熱蓋後，單擊“START/STOP”按鍵，系統開始工作，植球回流台開始工作。注意：如果加熱蓋打開，則底部和頂部將不開始預熱，系統也不會開始回流工藝流程。
- 在流程開始時，先進行底部預熱，當底部加熱溫度達到第 1 段的溫度值後，開始頂部預熱；當頂部溫度上升到設定的第 1 段流程的溫度值後，才開始加熱回流工藝流程。
- 運行至最後 1 個流程的最後 15 秒時，每 1 秒鐘報警一次，提示回流工藝流程即將結束。
- 流程結束後，系統進入待機狀態，視窗顯示“”。
- 打開加熱蓋後約 10 秒鐘，冷卻風扇自動啟動，開始吹冷風冷卻，時間及狀態視窗顯示“”。
若不蓋上加熱蓋，單擊“COOL”按鍵關閉冷卻風扇，則時間及狀態視窗顯示“”。
若蓋上加熱蓋後，單擊“COOL”按鍵關閉冷卻風扇，則時間及狀態視窗顯示“-”。
- 在流程運行過程中，如果單擊“START/STOP”按鍵，則系統停止工作。如果需要待溫度冷卻至第一段溫度以下才可再次單擊“START/STOP”按鍵，啟動回流焊工作。

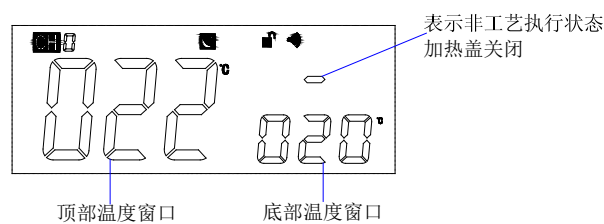
9. 在流程運行過程中，如果打開加熱箱，則停止加熱並開始聲光報警，即發出“嘀-嘀-”聲並且 LCD 視窗不斷閃爍。合上加熱蓋後，則聲光報警停止，繼續加熱。



注意：當工藝流程的時間設置為 0 時，將略過該工藝流程，直接進入下一個工藝段。

六、參數設置

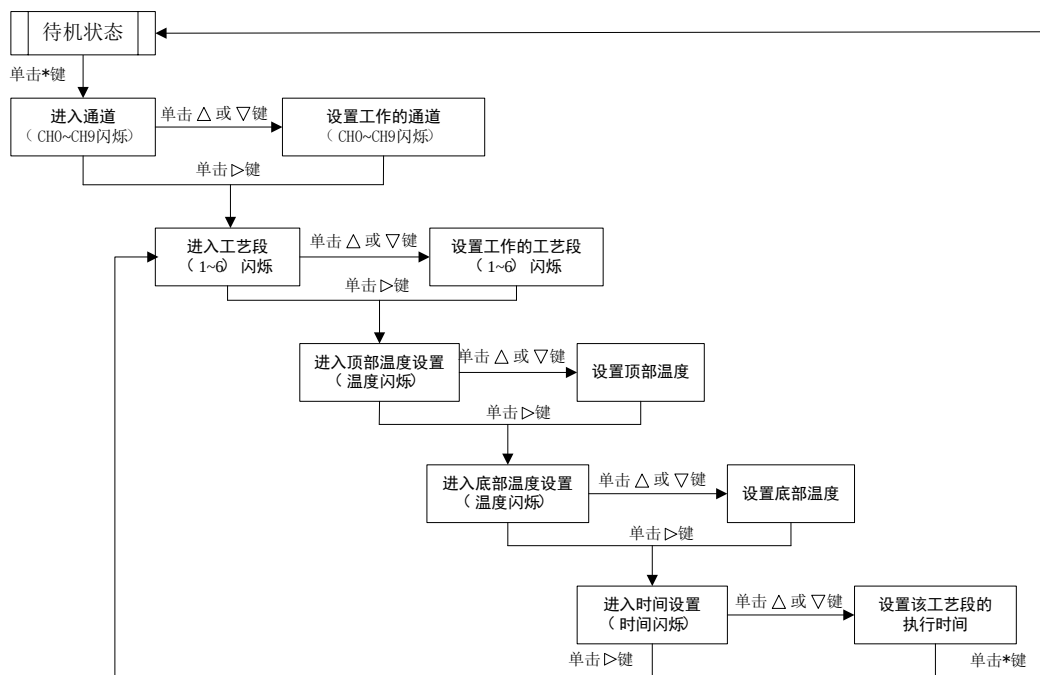
1. 接通電源，打開電源開關，系統為待機狀態時（視窗顯示 ），LCD 顯示的溫度為加熱箱的實際溫度，介面如下：



2. 此時，按住“*”鍵約 1 秒，視窗顯示“set”且系統發出“嘀”的一聲，表示進入參數設置。“CH”旁的數字閃爍，單擊“▶”鍵，進入回流焊工藝段的選擇（工藝段數位閃爍），可選擇需設置的工藝段，共有九個工藝段(1~9)；單擊“▲或▼”按鍵，則可選擇需設置的工作通道，共有十個通道(CH0~CH9)。

注：只有當數字在閃爍時，單擊“▲或▼”按鍵，才能改變數位，設置成合適的數值。

具體操作如下圖所示：



七、密碼設置

△注意：

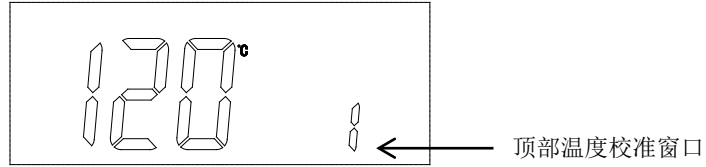
- 默認密碼為 000。
 - 重新設置密碼後，溫度設置被鎖定，將不能進行參數設置和通道選擇。只能選擇工藝段（1~6），參考參數。
1. 關閉電源開關，同時按“▲和▼”鍵不鬆開，直至打開電源開關、視窗顯示“C”和“set”，然後鬆開按鈕。該視窗表示需輸入正確的密碼才能進行密碼設置。
 2. 按“*”鍵，進入密碼輸入視窗，百位元的游標閃爍。
 3. 按“▲或▼”鍵，在閃爍游標所在的位置輸入密碼；輸入後，按“▶”鍵，移到下一位輸入。
 4. 密碼輸入正確，則進入密碼設置視窗，視窗顯示“🔒 Password”。若密碼輸入錯誤，則進入工作視窗。
 5. 進入密碼設置視窗後，按“*”鍵，開始設置新密碼。
 - 如果兩次輸入的密碼不相符，則密碼修改不成功，直接進入工作視窗，參數設置被鎖定。
 - 如果兩次輸入的密碼相同，則密碼修改成功，新密碼閃爍三次，同時系統發出“滴滴滴”三聲（設置了提示音時）後進入工作視窗。

八、溫度校準

進入工作狀態後，可以即時對頂部加熱器溫度、底部加熱器溫度進行校準。用烙鐵溫度測試儀進行校準步驟如下：

1. 選擇需校準溫度的通道，設置該通道的第 1 段溫度。

2. 蓋上加熱蓋後，單擊“START/STOP”按鍵，系統開始工作，加熱器開始加熱。
3. 待視窗顯示的加熱溫度穩定後，用烙鐵溫度測試儀測試頂部加熱器溫度或底部加熱器溫度。
4. 在工作進行中，按“*、▲、▼、▶”四個鍵，進入校準狀態，視窗顯示“C”約 1 秒，然後進入頂部溫度校準視窗，頂部溫度校準視窗顯示如下：



5. 此時，單擊“▶”鍵，進入下一個溫度校準視窗：

“1” ---表示頂部溫度校準

“2” ---表示底部溫度校準

6. 在溫度校準視窗（溫度不閃爍時），單擊“*”鍵，則視窗顯示溫度閃爍，此時，單擊“▲或▼”按鍵，輸入溫度測試儀上的校準溫度。輸入完成後，單擊“*”鍵，退出溫度校準。
7. 若輸入以上的溫度後，仍有偏差，則重複以上步驟，再次校準。